

EM UC7 Leicaウルトラミクロトーム

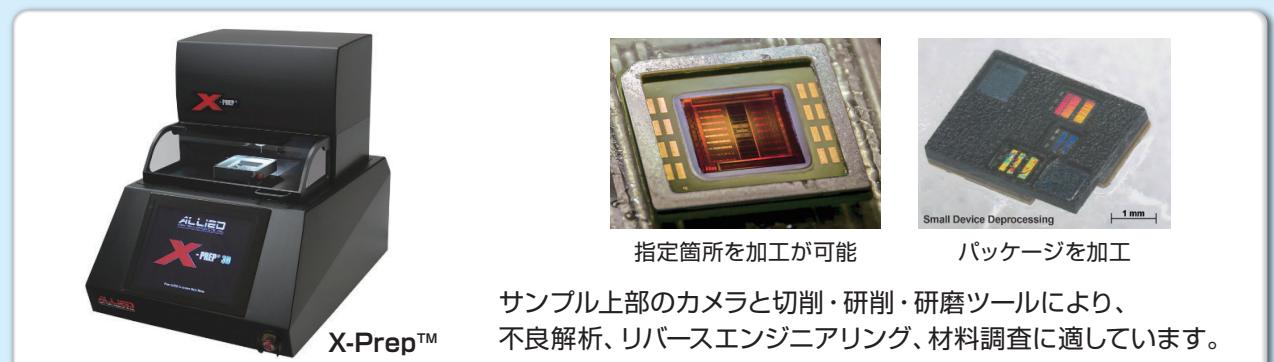
工程D

**特長・仕様**

- 100nm以下の超薄切片を作製することができます。
- 水を使わず観察面を作製することができます。
- 対象サンプル：高分子材料、無機材料、複合材料、柔らかい金属
- 寸法 / 重量：350(W)×530(D)×540(H)mm/40kg
(コントローラ部は除く)

**電子顕微鏡用
前処理機器のご案内**

サンプルの表面形態および内部構造の観察・解析には、適切な機器を用いた前処理を行うことが重要です。電子顕微鏡用のサンプル作製に適切な機器をご提案します。


X-Prep™ ALLIED 精密ミリング/ポリッシングシステム
**特長・仕様**

- ツールの回転数：5,000～100,000rpm
- 研磨対象サンプル：セラミック・シリコン・金属・ガラス
- 最大加工領域：100×100mm
- 寸法 / 重量：533(W)×686(D)×622(H)mm/95kg

【備考】：輸入製品のため仕入れ価格の変動・見直しにより、予告なく価格改定となる場合があります。
詳細価格のお問い合わせに関しましては、弊社各拠点より個別に見積もり対応させていただきます。

お問い合わせ

詳細は弊社サービスエンジニアまでお問い合わせください。

◎ 株式会社 日立ハイテクフィールディング

電子顕微鏡部

〒105-6410
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネススター
<https://www.hitachi-hightech.com/hfd/>

お客様サポートセンター

0120-203-813
フリーコール

S.I.navi 日立ハイテク会員制サイト(エスアイナビ)
<https://biz.hitachi-hightech.com/sinavi/>

●本カタログに掲載の内容は、予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載している写真や図は、標準仕様の場合です。装置の仕様や構成によって異なります。

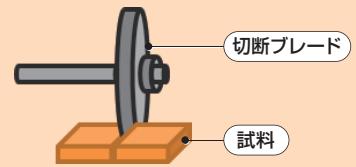
本カタログは2020年1月現在のものです。

DS1711010Rev.01

サンプル加工フロー

工程A

加工・観察機器に合わせたサンプルの切り出し

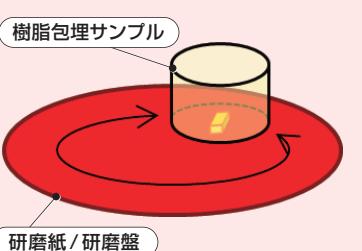


内部構造解析のための
断面作製の場合

透過像を得るための
薄片化の場合

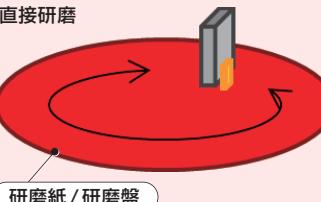
工程B

樹脂埋めしたサンプル
機械研磨



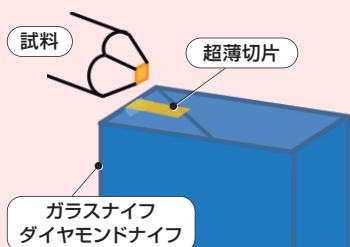
工程C

樹脂埋めしないサンプル
機械研磨

専用治具に取り付け
直接研磨

工程D

ミクロトームにて
超薄切片作製



SEM/TEMおよび分析機器を用いた観察・解析

お客様に安心してご使用いただけるよう、納入後のオペレーションサポート、メンテナンスにつきましてもメニューをご用意しております。

TechCut5™ ALLIED 精密高速切断機

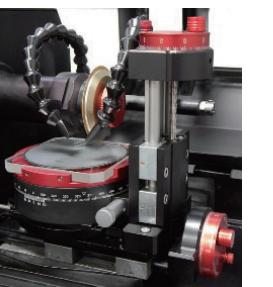
工程A



TechCut5™



大型サンプルの固定・切断が可能



切り出しの位置調整

切削条件(サンプルの送り速度および力)を制御することで、サンプルに応じた最適な条件で切削することができます。

特長・仕様

- さまざまな形状のサンプルを固定できる多様なアクセサリーがあります。
- サンプルの切り出し位置をミクロン単位で微調整できます。
- ブレードサイズ: 76 ~ 200mm
- 最大試料サイズ: 152(W) × 152(D) × 64(H)mm
- 寸法 / 重量: 620(W) × 545(D) × 476(H)mm / 67kg (オプション)

M-Prep5™/M-Prep6™ ALLIED 手動研磨装置

工程B



M-Prep5™

特長・仕様

- 給水機構を付属した手動研磨装置です。
- 研磨盤の回転数: 10 ~ 500rpm(10rpm刻み)
- 寸法 / 重量:
 - M-Prep5™: 381(W) × 660(D) × 229(H)mm / 30kg
 - M-Prep6™: 560(W) × 690(D) × 267(H)mm / 45kg

MetPrep3™/AD-5™ ALLIED 包埋試料研磨装置

工程B



AD-5™

MetPrep3™
プログラム設定画面

包埋サンプルの個別加重研磨

複数の試料研磨に適した半自動式の包埋試料研磨装置です。アタッチメントを交換することで、1個から最大6個までの試料を研磨できます。

特長・仕様

<MetPrep™/PowerHead>

- 25通りの研磨条件を登録することができます。
- 試料に対して2種類の荷重方式を選択可能であり、荷重の調節も可能です。
- サンプル個別加重・全体加重で研磨ができます
- 研磨盤/サンプル回転数: 40 ~ 600rpm / 0 ~ 150rpm(10rpm刻み)
- 寸法 / 重量: 380(W) × 683(D) × 569(H)mm

<AD-5™> 液体ディスペンサー

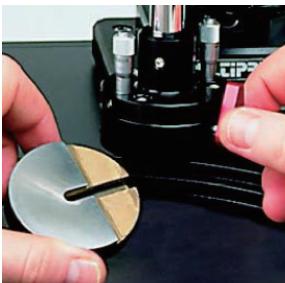
- 5種類の研磨剤液をセットできます。
- 25通りの条件を登録できます。

MultiPrep™システム ALLIED 精密研磨装置

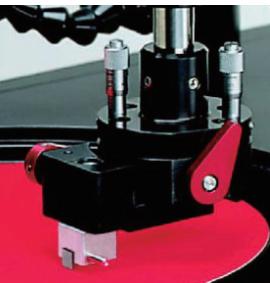
工程C



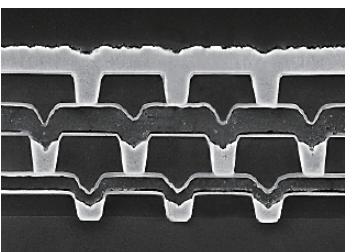
MultiPrep™システム



カムロックシステム



非包埋サンプルの断面研磨



FE SEM 観察 IC-断面



TEM 観察 IC-断面

デュアル
マイクロメーター

樹脂埋めしていない試料の断面研磨や平行研磨、半導体試料(ウェーハ*)の裏面研磨など多様な研磨用途に1台で対応可能な汎用性の高い半自動試料研磨装置です。

*12インチ(300mm)タイプもあります。

特長・仕様

- サンプルの回転(ローテーション)・反転(オシレーション)研磨ができます。
- 多彩な試料固定アクセサリーがあります。
- カムロックシステムによりサンプルの固定・着脱が手軽にできます。
- デジタルインジケーターにより1μm単位で研磨量を確認できます。
- サンプル傾斜調整角度: +10°/-2.5°(0.02°刻み)
- 研磨盤回転数: 10 ~ 350rpm(5rpm刻み)
- 寸法 / 重量: 381(W) × 680(D) × 508(H)mm / 43kg